

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年4月23日、4月24日、4月27日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	见附件	
会议时间	2026年4月23日 14:00-16:00 2026年4月24日 14:00-16:00 2026年4月27日 16:30-17:30	
会议地点	佰维存储东莞晶圆级先进封测制造中心一楼会议室、佰维存储三楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 当前 AI 背景下，公司的战略布局是怎样的？</p> <p>A1: 公司整体战略规划主要是围绕“存储+先进封测”布局。在存储端，公司以全面的存储技术能力服务 AI 场景应用，覆盖主控芯片设计、介质研究与设计、解决方案研发以及先进封测等技术环节。通过这些技术布局，公司能够深度覆盖 AI 新兴端侧、企业级存储以及智能汽车等 AI 应用场景。在先进封测端，公司通过先进封装技术打造生态链，覆盖 AI 硬件基础设施“存、算、运”三大核心领域：“存”是面向先进存储芯片的 FOMS（扇外型存储堆叠）系列，满足大容量、高密度存储需求；“算”是聚焦算力与存储融合的 CMC（存算芯粒）系列，适配存算合封的技术发展趋势；“运”是主攻高速信号传输的 OEC（光电共封装）系列，契合超高速互联的应用需求；三大产品线可全方位响应 AI 时代对存（大容量存储）、算（存算合封）、运（高速信号传输）的核心诉求。基于以上布局，公司将从存储解决方案供应商升级为 AI 时代“存储+先进封测”全栈技术服务商，为公司深耕 AI 产业链“存算运融合”领域构筑了坚实的长期竞争壁垒。相关进展请以公司正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q2. 公司在介质设计上有哪些布局？</p> <p>A2: 目前，公司已与国内头部晶圆代工企业建立长期稳定的合作关系，保障核心产能供给与工艺协同升级。依托成熟的代工资源与差异化发展战略，公司采取错位竞争的产品布局思路。当前上游原厂更多聚焦大容量存储领域，而公司重点布局小容量存储介质领域，深度聚焦各类端侧设备的刚需场景，充分适配 AI 新兴端侧、物联网、工业控制等细分领域的应用需求，不断强化公司在细分赛道核心竞争力。</p>	

	<p>Q3 公司一季度库存 120 亿元是否包括了新签的采购长约？目前全年来看供应趋紧，公司除了长约外是否还有其他保障供应的方法？</p> <p>A3：公司签订的长期采购合同总计承诺采购金额为 15 亿美元，承诺采购期自 2026 年 4 月起至 2028 年 3 月末止，总计 24 个月，采购进度为 8 个季度内均匀采购，采购价格为锁定单价。公司签订合同提前锁定未来 24 个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配。截至 2026 年一季度末，公司的库存规模为 120.69 亿，相较 2025 年底增长 53.39%，该库存并未包含上述长期采购合同。此外，公司持续深化与全球主要存储晶圆原厂的合作，持续签署 LTA。公司将在 2026 年继续做好 LTA 的执行，同时会积极推进其他长期采购合约，保障供应资源。</p> <p>Q4 请问东莞晶圆级封装产线目前建设进度如何？2026 年是否能够产生营收？</p> <p>A4：公司位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目进展顺利，正按客户节奏稳步推进打样与验证工作。如果客户导入顺利，预计将于 2026 年年底起正式贡献收入。通过该项目，公司将为客户交付“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案，进一步强化在存算融合领域的技术壁垒与市场竞争力，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q5. 公司一季度业绩靓丽，如何看二季度及后续公司的盈利能力持续性？</p> <p>A5：当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于 AI 应用及 Token 调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向 2027 年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，整体成本的变化相对平滑。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，产品价格的传导路径较为平顺。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q6. 公司自研主控方面今年预计有多少的出货量？</p> <p>A6：在自研主控方面，公司第一款国产自研主控 eMMC（SP1800）已成功量产，实现多个国产突破，已批量交付客户，在智能穿戴、手机、车规等多场景落地，兼具高性能、低功耗、高可靠与可定制优势，获得头部客户认可，其中，车规级解决方案获得国家市场监督管理总局首批认证审查的芯片产品白名单。公司预计 2026 年自研主控出货量超过 2500 万颗，显著提升公司的产品竞争力，实际销售数量请以后续正式信息披露公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。与此同时，公司自研 UFS 3.1 主控研发进展顺利，核心性能指标表现优异，已于 2026 年 2 月投片，计划将在 2026 年下半年开始导入终端客户，将进一步增强在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等高端存储市场的竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>Q7. 公司晶圆级先进封测项目具备哪些核心竞争壁垒？</p> <p>A7：公司积极推进与 IC 设计厂商、晶圆制造厂商以及终端客户等产业链伙伴的合作，不断深化与合作伙伴的战略合作关系，形成资源共享，促进技术合作，共建产业生态。公司已具备先进 Chiplet 封装设计、仿真、制造以及与存储系统整合的能力，构建了完整的、国际化的、专业的晶圆级先进封装设计和工艺技术</p>
--	---

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

	团队，具备成熟研发和量产经验，相关技术方案受到了客户的认可并开始导入。此外公司基于前期在先进封装领域积累的经验，建立了成熟的供应链体系，晶圆级先进封测制造项目可以有效利用公司现有供应链资源，降低制造和采购成本。
附件清单	无
日期	2026年4月23日、2026年4月24日、2026年4月27日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。

附件：

序号	公司名称	姓名
1	Alphahill	Derek Ma
2	New China	周润南
3	Oakwise	Felix Huang
4	Rime Capital	James Gao
5	Y2	Devin
6	博时基金	戴嘉佑
7	诚通香港	罗歆迪
8	大华信安	李霄
9	大华信安	胡越
10	富德资产	李泉霖
11	工银理财	龚嘉然
12	景林	孙玮
13	慕华科创	周天奇
14	慕华科创	Weifan
15	影石	邱是
16	个人投资者	汤鹤松
17	CIC	Leo Dang
18	Mirae	王一晴
19	Orix Capital	Tianjun Wang
20	富国基金	耿家琛
21	天壹资本	张宇翔
22	农银国际自营	李皓文
23	Orient Securities	Kathy Gu
24	信银投资	冯雷
25	信银投资	曲一奇
26	P72	Tiantao Zheng
27	North Rock	Hedy Wang
28	Pinpoint	David Ni
29	Oasis	Richard Guan
30	Jump Trading	文博
31	雅润	李钰涵
32	Lakebleu	Annie Jin
33	Dragonstone Capital	孟俊杰
34	Viridian	Muyang Zhao
35	盈峰集团	冯斯灏
36	增途资本	黄博涵
37	China alpha	Steven Teng
38	Dymon Asia	Tang Lin
39	Polymer	Gary Hsu
40	Hong Shang	Ann Wang
41	GBA	汪苏洋

42	GBA	郭一裕
43	CPIC	Nick Feng
44	懿昊资本	范毅
45	Factorial	Kyle Chan
46	双城资本	张磊
47	华夏基金香港	景然
48	中银	钟宇
49	Golden Link	聂亚群
50	Golden Link	刘逢炜
51	韩华资管	朴成杰
52	道明资管	张斯淙
53	路博迈	肖笛
54	国泰海通	邴奕滢
55	国泰海通	孙炫浩
56	国泰海通	王海涛